KB-3150N（ANSI：FR-1/JIS：PP7F）

覆铜箔酚醛树脂纸基层压板

特 点

- 在高温下弓曲率、扭曲率小于 1.0%
- 适合之冲孔温度为 40～70℃

Features

- In high temperature warpage and twist both less than 1.0%
- Suitable for punching at 40 ~70℃

General Properties 一般特性

Test Item 测试项目		Unit 单位	Test Condition 处理条件	Testing Method 测试方法	Specification 规格值	Typical Value 典型值
Solder Resistance 耐焊性 (float 260℃)		Sec	A	JIS C 6481	≥10	20～30
Heat Resistance 耐热性		——	130℃ 30min	JIS C 6481	No Change 无异常	No Change 无异常
Peel Strength (Copper Foil 35 μ m) 铜箔剥离强度 (35 μ m 铜箔)		kgf/cm	A float 260℃/10 Sec	JIS C 6481	≥1.2	1.7~2.0 1.6~1.9
Flexural Strength 屈曲强度	Lengthwise 纵向	kgf/mm^2	A	JIS C 6481	≥8	15~17
	Crosswise 横向				≥8	14~15
Volume Resistivity 体积阻抗系数		Ω-cm	C-96/20/65 C-96/20/65+C-96/40/90	JIS C 6481	5×10^9 5×10^8	1.0×10^{12}~10^{13} 1.0×10^{12}~10^{13}
Surface Resistivity 表面抗阻	Adhesive Side 粘接剂面	Ω	C-96/20/65 C-96/20/65+C-96/40/90	JIS C 6481	1×10^{10} 1×10^9	1.0×10^{11}~10^{12} 1.0×10^{10}~10^{11}
	Laminate Side 积层板面		C-96/20/65 C-96/20/65+C-96/40/90		1×10^9 1×10^7	1.0×10^{10}~10^{11} 1.0×10^9~10^{10}
Insulation Resistance 绝缘抗阻		Ω	C-96/20/65 C-96/20/65+D-2/100	JIS C 6481	1×10^9 1×10^6	1.0×10^{11}~10^{12} 1.0×10^8~10^9
Chemical Resistance 耐化学性		——	3% NaOH 40℃ 3min 3%氢氧化钠 40℃3 分钟	JIS C 6481	No Change 无异常	No Change 无异常
			Boiled in trichloroethylene for 3 min 三氯乙烯中煮沸 3 分钟	JIS C 6481	No Change 无异常	No Change 无异常
Moisture Absorption 吸水性		%	E-24/50+D-24/23	JIS C 6481	≤2	0.8～1.0
Flammability 阻燃性		Rating	A	UL94	UL94 V-0	V-0
Dielectric Constant (1 MHz) 介电常数 (1 MHz)		——	C-96/20/65 C-96/20/65+D-24/23	JIS C 6481	≤5.5	4.0~5.0
					≤6.0	4.5~5.5
Dissipation Factor 介质损耗因子		——	C-96/20/65 C-96/20/65+D-24/23	JIS C 6481	≤0.05	0.025～0.035
					≤0.1	0.045~0.055
CTI Value CTI 值		V	0.1% NH_4CL	IEC 60112	≥175	≥175
Punching Temperature 冲孔温度		℃	A	GB/T4722	40-70	40-70

Remarks: Typical values for reference only 注：典型值只作参考 Stand values according to JIS-C-6485 规格值参照 JIS-C-6485

A = Keep the specimen originally without any process 保持原样,不作处理

C = Temperature and humidity conditioning 在恒温恒湿的空气中处理

D = Immersing in distilled water with temperature control.浸在恒温的水中处理

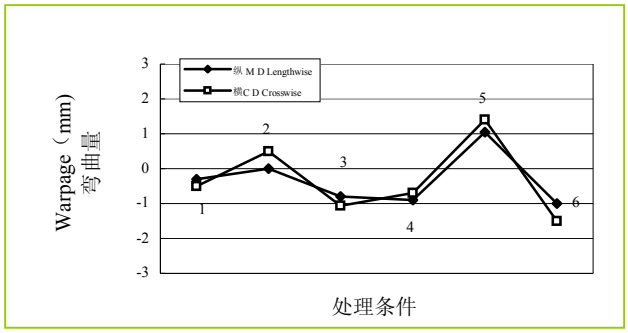
E = Temperature conditioning 在恒温的空气中处理

KB-3150N（ANSI：FR-1/JIS：PP7F）

覆铜箔酚醛树脂纸基层压板

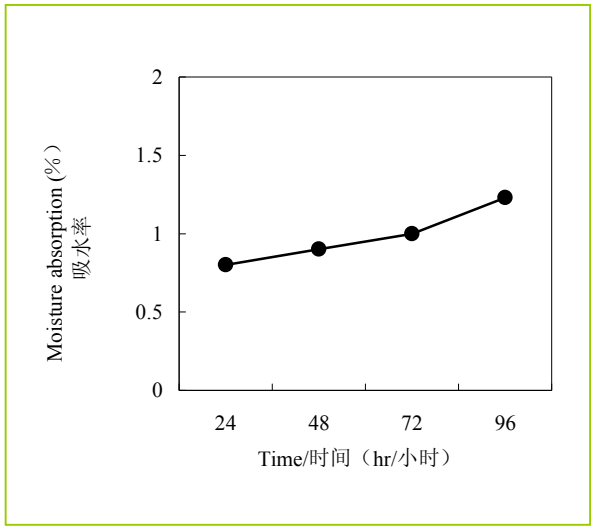
Speciality Chart 板材特性图

Warpage of PCB during processing/印制电路板加工时弯曲度(Thickness 1.6mm single side)

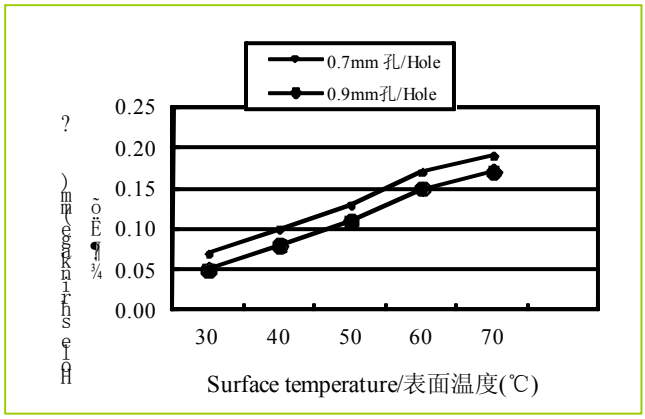


1.Feeding 投料	2.Heating at 130℃ for 90 sec 130℃下加热 90 秒	3.Etching. Rinsing. Drying 蚀刻，清洗，烘干
4.Heating at 200℃ for 30 sec 200℃下加热 30 秒	5.Punching at 50℃ 50℃下冲孔	6.Soldering at 260℃for 5sec 260℃ 焊锡 5 秒

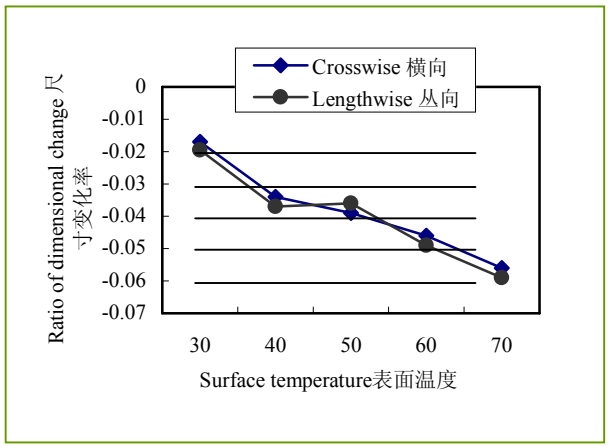
Moisture absorption 吸水率



Punched hole shrinkage
冲孔后孔径收缩



Dimensional change of punched PCB
冲孔后之尺寸变化



Purchasing Information 采购信息

Type 类型	Thickness 厚度	Copper Cladding 铜箔厚度	Regular Size（mm） 常规尺寸	CTI Value CTI 值
KB-3150N FR-1	0.8mm～1.6mm	18μm 35μm 70μm	1020*1020mm（40"* 40"） 1020*1220mm（40"* 48"）	175V

Note: Other sheet size and thickness could be available upon request.
可根据客户要求提供其它尺寸和厚度